

國立陽明交通大學 函

地址：300093 新竹市大學路1001號
聯絡人：王秀蘭
聯絡電話：03-5131583
電子郵件：aretehp@nycu.edu.tw

受文者：臺北市立松山高級工農職業學校

發文日期：中華民國114年4月7日
發文字號：陽明交大博雅百川字第1140012848號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：2025 TSIC海報、2025 TSIC簡章 請至附件下載區(<https://edocattachment.nycu.edu.tw>)以文號：1140012848及認證碼：96FB9E8350下載附件檔案

主旨：有關「新思科技X陽明交大臺灣半導體IC營」暑期營隊活動，惠請貴單位協助公告並鼓勵學生報名參加，請查照。

說明：

一、【你暑假還在補習？我們已經在設計晶片了。】由國立陽明交通大學攜手全球電子設計自動化領導企業新思科技（Synopsys）共同舉辦，「2025 台灣半導體IC營」重磅登場。本營隊專為對科技、工程、電子設計有興趣的高中與大學生打造，內容涵蓋理論、實作、產業導覽與國際趨勢，帶你走進晶片的世界，探索未來的可能。

二、課程內容：

- (一) 晶片設計實作課：邏輯基礎到硬體實做，體驗設計晶片第一步。
- (二) 產業現況解析：產業大佬告訴你半導體產業怎麼賺錢？未來機會在哪？
- (三) 科學園區實地參訪：親身瞭解半導體製程操作現場。

松山工農 1140408



NOAA1143004609

(四)主管直球問答：不只是演講，新思科技資深主管當面為你的學職涯解惑。

(五)線上預習plus課後延伸：營前四堂線上課，英文梯次營後開發板帶回家。

三、沒有尷尬破冰、沒有團康遊戲、沒有空洞流程。這裡只有知識、實作、還有產業第一手消息！

四、報名連結：<https://lihi.cc/gqWub>。

正本：全國高級中等學校、各公私立大專校院

副本：

